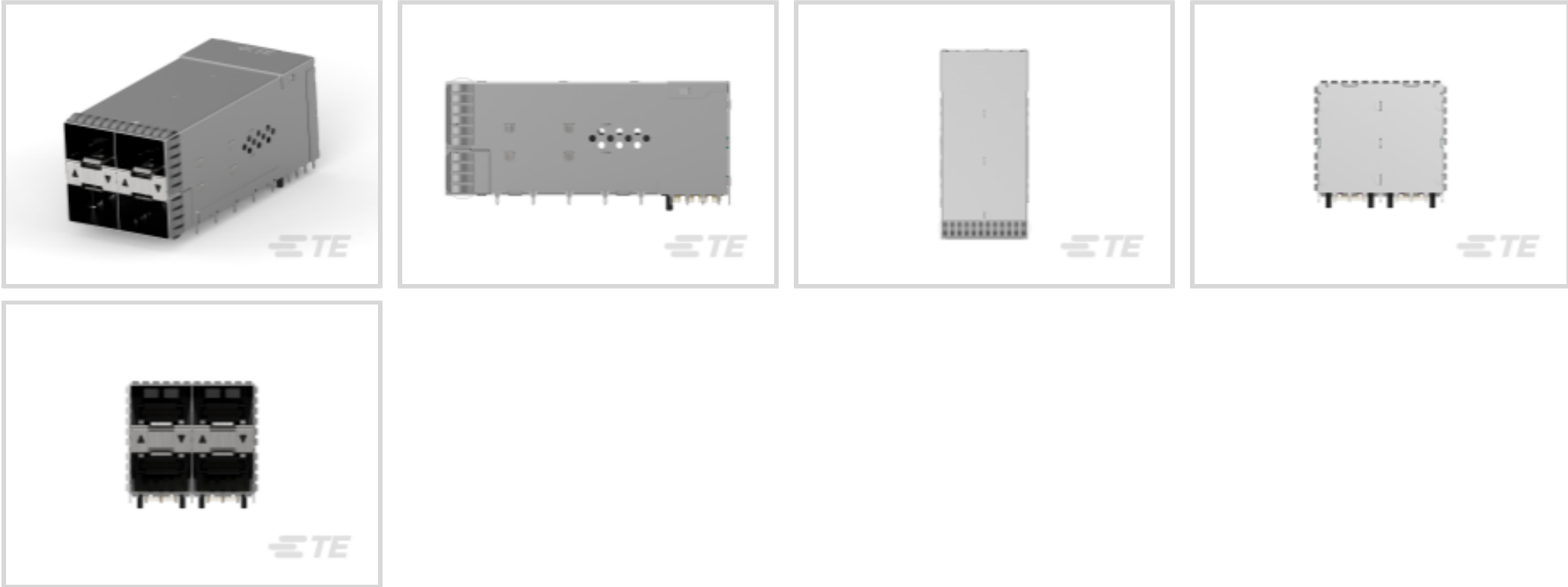




连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子 > SFP56 堆叠壳体组件：EMI 弹片



外形尺寸: zSFP + 堆叠 (SFP56)
插拔式 I/O 产品类型: 带集成连接器的壳体组件
中心线 (间距) : .6 mm [.018 in]
电路应用: Signal
工组温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

[所有 SFP56 堆叠壳体组件：EMI 弹片 \(48\)](#)

产品特性

产品类型特性

笼子类型	堆叠
外形尺寸	zSFP + 堆叠 (SFP56)
插拔式 I/O 产品类型	带集成连接器的壳体组件

结构特性

位数	20
端口数量	4
端口矩阵配置	2 x 2

电气特征

数据速率（最大值）	56 Gb/s
-----------	---------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

壳体特性

中心线 (间距)	.6 mm[.018 in]
----------	----------------



使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

插拔式 I/O 应用	SFP28
电路应用	Signal

其他

包括的光管	是
EMI 遏制特性类型	内部/外部 EMI 簧片

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2343522-0_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2343522-0_A.3d_igs.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2343522-0_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[产品规格](#)

英文版本